Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018048

International filing date: 03 December 2004 (03.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2003-436226

Filing date: 04 December 2003 (04.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 17 February 2005 (17.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年12月 4日

出 願 番 号 Application Number:

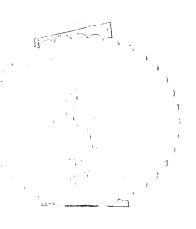
特願2003-436226

[ST. 10/C]:

[JP2003-436226]

出 願 人 Applicant(s):

三星ダイヤモンド工業株式会社



2005年 1月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 1) 11)



特許庁長官 今井 康夫 殿

【書類名】

【整理番号】

【提出日】

【あて先】

【国際特許分類】

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府吹田市南金田2丁目12番12号 三星ダイヤモンド工業

株式会社内 岡島 康智

CO3B 33/02

平成15年12月 4日

【氏名】

【発明者】

【住所又は居所】

特許願

P03-27

大阪府吹田市南金田2丁目12番12号 三星ダイヤモンド工業

株式会社内 中田 勝喜

【氏名】

【特許出願人】

【識別番号】

390000608

【氏名又は名称】

三星ダイヤモンド工業株式会社

【代表者】 三字 泰明

【提出物件の目録】

【物件名】

特許請求の範囲 1 明細書 1

【物件名】 【物件名】

図面 1

【物件名】

要約 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

脆性を有するマザー基板にスクライブラインを形成し、形成されたスクライブラインに沿って前記マザー基板を割断する工程を含む基板割断方法において前記マザー基板を搬送するに際し、それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いて前記マザー基板をマザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、前記吸着部材のそれぞれを回動させ、それによって少なくとも前記マザー基板の両主面を上下方向に反転させることを特徴とする基板割断方法。

【請求項2】

吸着部材のそれぞれを、互いに平行で吸着部材の長手方向に沿って延びかつ吸着部材の 短手方向の幅におけるほぼ中心部分を貫通する回転軸の周りで回動させる請求項1に記載 の基板割断方法。

【請求項3】

マザー基板を短冊状の小マザー基板に予め割断し、それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いて前記小マザー基板を小マザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、前記吸着部材のそれぞれを回動させ、それによって少なくとも前記小マザー基板の両主面を上下方向に反転させる請求項1または2に記載の基板割断方法。

【請求項4】

脆性を有するマザー基板にスクライブラインを形成し、形成されたスクライブラインに沿って前記マザー基板を割断する工程を含む基板割断工程において前記マザー基板を搬送するに際し、それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いて前記マザー基板をマザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、隣り合う前記各吸着部材の少なくとも一方を回動させ、それによって前記マザー基板に形成されたスクライブラインに沿ってこのマザー基板を割断することを特徴とする基板割断方法。

【請求項5】

吸着部材のそれぞれを、互いに平行で吸着部材の長手方向に沿って延びかつ吸着部材の 短手方向の幅におけるほぼ中心部分を貫通する回転軸の周りで回動させ、かつマザー基板 を、マザー基板に形成されたスクライブラインが前記回転軸とほぼ平行にかつ隣り合う吸 着部材どうしの略中間に位置するように前記吸着面で吸着する請求項4に記載の基板割断 方法。

【請求項6】

マザー基板を短冊状の小マザー基板に予め割断し、それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いて前記小マザー基板を小マザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、前記吸着部材のそれぞれを回動させ、それによって少なくとも前記小マザー基板の両主面を上下方向に反転させる請求項4または5に記載の基板割断方法。

【請求項7】

それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いてマザー基板をマザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、隣り合う前記各吸着部材の少なくとも一方を回動させるに際し、この回動と同時または回動後に、隣り合う前記各吸着部材の回転軸をそれぞれの軸線間の距離が長くなるように変位させることを特徴とする請求項4から6のいずれか1つに記載の基板割断方法。

【請求項8】

それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いて前記マザー基板の複数をそれぞれのマザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、隣り合う前記各吸着部材どうしを正逆が互いに異なる回転方向に回動させることを特徴とする請求項4から7のいずれか1つに記載の基板割断方法。

【請求項9】

脆性を有するマザー基板を単位基板に割断する基板割断装置であって、前記マザー基板 にスクライブラインを形成するスクライブ部と、形成されたスクライブラインに沿って前 記マザー基板をブレークするブレーク部と、少なくとも前記各部の間で前記マザー基板ま たは前記単位基板を搬送する基板搬送部とを具備し、基板搬送部が、前記基板をそれぞれの基板の主面で吸着して保持する吸着面を備えた複数の吸着部材を有し、吸着部材のそれぞれは、回転軸を有し、前記基板を吸着保持した状態で少なくとも前記基板の両主面が上下方向に反転するよう前記各基板をそれぞれの回転軸周りに回動させる基板吸着回動手段を有することを特徴とする基板割断装置。

【請求項10】

吸着部材の回転軸のそれぞれが、互いに平行で、吸着部材の長手方向に沿って延びかつ 吸着部材の短手方向の幅におけるほぼ中心部分を貫通する請求項9に記載の基板割断装置

【請求項11】

少なくとも1つの吸着部材が、多孔質状の吸着面を有する請求項 $9\sim1$ 0のいずれか1つに記載の基板割断装置。

【請求項12】

吸着部材によって回動される基板が、マザー基板を短冊状に割断した小マザー基板である請求項 $9\sim1$ 1のいずれか1つに記載の基板割断装置。

【請求項13】

吸着面の大きさが異なる吸着部材を少なくとも 1 つ有する請求項 $9 \sim 1$ 2 のいずれか 1 つに記載の基板割断装置。

【請求項14】

吸着部材によって回動される基板は、長辺が1メートルを超えずかつ厚さが1.5mmを超えない請求項 $9\sim13$ のいずれか1つに記載の基板割断装置。

【請求項15】

基板吸着回動手段が、吸着部材の回転軸を回動させる回転軸駆動部と、回転軸駆動部を介して少なくとも回転軸の回転角度および回転方向を制御する制御部と、回転軸を回動させる際に、この回動と同時または回動後に、隣り合う前記各吸着部材の回転軸をそれぞれの軸線間の距離が長くなるように変位させる回転軸変位部とを有することを特徴とする請求項9から14のいずれか1つに記載の基板割断装置。

【請求項16】

回転軸変位部が、複数の吸着部材の少なくとも1つを選択的に水平方向および/または 垂直方向に移動させる請求項15に記載の基板割断装置。

【請求項17】

基板搬送部が、吸着部材によって回動された基板を隣接するテーブルの主面上に位置決めして整列させる位置決め機構をさらに具備してなる請求項 $9\sim15$ のいずれか 1 つに記載の基板割断装置。

【請求項18】

ブレーク部が、スクライブラインが形成されたマザー基板を搬送する第1のコンベアと、第1のコンベアの搬送方向における少なくとも一方の端部近傍に配置され、第1のコンベアで搬送され搬送方向におけるコンベア端部から突出したマザー基板の端部を押圧し、それによって単位基板にブレークする基板押圧部材とを具備してなる請求項 $9\sim1$ 7のいずれか1つに記載の基板割断装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】基板割断方法および基板割断装置

【技術分野】

[0001]

この発明は、脆性を有するマザー基板にスクライブラインを形成し、形成されたスクライブラインに沿って前記マザー基板を単位基板に割断する基板割断方法および基板割断装置に関する。

【背景技術】

[0002]

液晶表示パネルは、2枚のガラス基板を貼り合わせ、そのギャップに液晶が注入されて表示パネルを構成する。ガラス基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板は、通常、基板割断装置によって所定の大きさに割断される。

特許文献1 (特開平11-116260号公報) には、貼り合わせマザー基板を所望の大きさにスクライブして割断するガラス加工装置が開示されている。

【特許文献1】特開平11-116260号公報

[0003]

テレビジョン受像機用やパソコンモニター用の液晶表示パネルは、年々大型化が進み、液晶表示パネルに使用されるマザー基板もこれに応じて年々大型化が図られている。

このような大型のマザー基板を割断することにより、多数の単位基板が製造される。

上記の工程では、それぞれの工程間でマザー基板または単位基板を搬送するために、基板搬送装置が用いられる。

[0004]

基板搬送装置は、通常、前記の基板を真空吸着可能な真空吸着機構と、真空吸着機構により真空吸着された基板を反転する基板反転機構と、これらの機構を支持してX軸および Y軸方向に移動可能な移動機構とを有する少なくとも1つの搬送ロボットを備えている。

マザー基板を割断する際は、まず、テーブル上の基板に対して、所定のスクライブ圧を加えた状態でカッターホイールチップを転動させることにより、基板A面にスクライブラインを形成する。次いで、基板を吸着し反転させた後、基板A面の裏面となる基板B面に対しブレークバー等を押圧して基板A面をブレークする。

次いで、上記と同様に、基板B面にスクライブラインを形成し、基板を吸着し反転させた後、基板A面に対しブレークバー等を押圧して基板B面をブレークする。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

しかしながら、液晶表示パネルに使用されるマザー基板が大型化されると、マザー基板を真空吸着する真空吸着機構および真空吸着機構により真空吸着された基板を反転する基板反転機構は大型化され、基板の反転に要する面積は大きくなる。したがって、装置の設置面積の増大を招くことになる。

また、液晶表示パネルに使用されるマザー基板が大型化されると、これらの基板を反転する際に基板に加わる外力が大きくなり、基板内部に歪みを発生させ、それによって好ましくないクラックや基板の欠けを発生させたりするおそれがある。

[0006]

この発明はこのような従来の問題点に鑑みてなされたものであり、基板の反転を含む基板搬送における基板の損傷を防止し、これらの基板搬送機構を有する基板割断装置の小型化によって設置面積を減少させることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0007]

この発明によれば、脆性を有するマザー基板にスクライブラインを形成し、形成された スクライブラインに沿って前記マザー基板を割断する工程を含む基板割断方法において前 記マザー基板を搬送するに際し、それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いて前記 マザー基板をマザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、前記吸着部材のそれぞれを回動させ、それによって少なくとも前記マザー基板の両主面を上下方向に反転させることを特徴とする基板割断方法が提供される。

[0008]

この発明の別の観点によれば、脆性を有するマザー基板にスクライブラインを形成し、形成されたスクライブラインに沿って前記マザー基板を割断する工程を含む基板割断工程において前記マザー基板を搬送するに際し、それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いて前記マザー基板をマザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、隣り合う前記各吸着部材の少なくとも一方を回動させ、それによって前記マザー基板に形成されたスクライブラインに沿ってこのマザー基板を割断することを特徴とする基板割断方法が提供される

[0009]

この発明のさらに別の観点によれば、脆性を有するマザー基板を単位基板に割断する基板割断装置であって、前記マザー基板にスクライブラインを形成するスクライブ部と、形成されたスクライブラインに沿って前記マザー基板をブレークするブレーク部と、少なくとも前記各部の間で前記マザー基板または前記単位基板を搬送する基板搬送部とを具備し、基板搬送部が、前記基板をそれぞれの基板の主面で吸着して保持する吸着面を備えた複数の吸着部材を有し、吸着部材のそれぞれは、回転軸を有し、前記基板を吸着保持した状態で少なくとも前記基板の両主面が上下方向に反転するよう前記各基板をそれぞれの回転軸周りに回動させる基板吸着回動手段を有することを特徴とする基板割断装置が提供される。

【発明の効果】

[0010]

この発明の基板割断方法では、液晶表示パネルに使用されるマザー基板が大型化されてもマザー基板を予め面積の小さい小基板に割断しておくことにより、この小基板を複数の吸着部材でそれぞれ真空吸着して反転することができるので、基板の反転に要する面積は小さくなり、装置の設置面積を抑えることができる。さらに、これらの基板を反転する際に基板に加わる外力を小さくすることができるので、好ましくないクラックや欠けの発生を抑えることができる。

[0011]

吸着部材のそれぞれを、互いに平行で吸着部材の長手方向に沿って延びかつ吸着部材の 短手方向の幅におけるほぼ中心部分を貫通する回転軸の周りで回動させるので、最小の回 動軌跡で基板を回動させることができ、基板に加わる回動時の外力を最小化でき、それに よって基板の損傷を防止できる。

[0012]

マザー基板を短冊状の小マザー基板に予め割断し、それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いて前記小マザー基板を小マザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、前記吸着部材のそれぞれを回動させ、それによって少なくとも前記小マザー基板の両主面を上下方向に反転させるので、回動に要する面積を減らし、装置の設置面積を減らすことができる。

[0013]

この発明の別の観点による基板割断方法では、マザー基板の割断とマザー基板およびマザー基板を割断してなる小マザー基板あるいは単位基板の搬送とを1つの装置で行うことができる。

[0014]

吸着部材のそれぞれを、互いに平行で吸着部材の長手方向に沿って延びかつ吸着部材の 短手方向の幅におけるほぼ中心部分を貫通する回転軸の周りで回動させ、かつマザー基板 を、マザー基板に形成されたスクライブラインが前記回転軸とほぼ平行にかつ隣り合う吸 着部材どうしの略中間に位置するように前記吸着面で吸着するので、マザー基板の割断に 要する回転軸の周りのトルクをマザー基板に有効に伝達することができる。

[0015]

マザー基板を短冊状の小マザー基板に予め割断し、それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いて前記小マザー基板を小マザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、前記吸着部材のそれぞれを回動させ、それによって少なくとも前記小マザー基板の両主面を上下方向に反転させるので、吸着部材の寸法を小さくすることができる。

[0016]

それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いて前記マザー基板をマザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、隣り合う前記各吸着部材の少なくとも一方を回動させるに際し、この回動と同時または回動後に、隣り合う前記各吸着部材の回転軸をそれぞれの軸線間の距離が長くなるように変位させるので、マザー基板を割断させる際に、割断された基板どうしの各端面が接触し合い、それによって基板端面に損傷が生じることを防止することができる。

[0017]

それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いて前記マザー基板の複数をそれぞれのマザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、隣り合う前記各吸着部材どうしを正逆が互いに異なる回転方向に回動させるので、吸着部材の回転軸と直交する方向にスクライブラインが平行に形成されたマザー基板を連続してあるいは一度に割断することができる。

[0018]

この発明の基板割断装置では、基板の反転に要する面積は小さくなり、装置の設置面積を抑えることができる。さらに、これらの基板を反転する際に基板に加わる外力を小さくすることができるので、好ましくないクラックや欠けの発生を抑えることができる。

[0019]

吸着部材の回転軸のそれぞれが、互いに平行で、吸着部材の長手方向に沿って延びかつ 吸着部材の短手方向の幅におけるほぼ中心部分を貫通するので、最小の回動軌跡で基板を 回動させることができ、基板に加わる回動時の外力を最小化でき、それによって基板の損 傷を防止できる。

[0020]

少なくとも1つの吸着部材が、多孔質状の吸着面を有するので、吸着部材の吸着面の面積と前記吸着面に接触する基板の接触面積との比率が変化しても、基板の吸着が可能になる。よって異なるサイズの基板を吸着して反転させることができる。

[0021]

吸着部材によって回動される基板が、マザー基板を短冊状に割断した小マザー基板であるので、大きな基板を反転させる大きな反転手段が不要になり、回動に要する面積を減らし、装置の設置面積を減らすことができる。

[0022]

吸着面の大きさが異なる吸着部材を少なくとも1つ有するので、吸着する基板のサイズ に応じて使用する吸着部材の個数を変えることができ、様々なサイズの基板を搬送するこ とができる。

[0023]

吸着部材によって回動される基板は、長辺が1メートルを超えずかつ厚さが1.5 mm を超えないので、回動に要する面積を減らし、装置の設置面積を減らし、基板の損傷を防 止することができる。

[0024]

基板吸着回動手段が、吸着部材の回転軸を回動させる回転軸駆動部と、回転軸駆動部を介して少なくとも回転軸の回転角度および回転方向を制御する制御部と、回転軸を回動させる際に、この回動と同時または回動後に、隣り合う前記各吸着部材の回転軸をそれぞれの軸線間の距離が長くなるように変位させる回転軸変位部とを有するので、それぞれが吸着面を備えた複数の吸着部材を用いて前記マザー基板の複数をそれぞれのマザー基板の主面で吸着して保持し、次いで、隣り合う前記各吸着部材の少なくとも一方を回動させ、それによって前記マザー基板に形成されたスクライブラインに沿ってこのマザー基板を割断

することができる。このとき、回転軸変位部により、割断された基板どうしの各端面が接触し合い、それによって基板端面に損傷が生じることを防止することができる。

[0025]

回転軸変位部が、複数の吸着部材の少なくとも1つを選択的に水平方向および/または垂直方向に移動させるので、マザー基板の大きさやマザー基板に形成されたスクライブラインの間隔に応じて吸着部材の間隔を変えたりすることができる。また、割断された基板どうしの各端面が接触し合い、それによって基板端面に損傷が生じることを防止することができる。

[0026]

基板搬送部が、吸着部材によって回動された基板を隣接するテーブルの主面上に位置決めして整列させる位置決め機構を具備するので、基板を反転した際に基板がずれても修正される。

[0027]

ブレーク部が、スクライブラインが形成されたマザー基板を搬送する第1のコンベアと、第1のコンベアの搬送方向における少なくとも一方の端部近傍に配置され、第1のコンベアで搬送され搬送方向におけるコンベア端部から突出したマザー基板の端部を押圧し、それによって単位基板にブレークする基板押圧部材とを具備するので、ブレークする機構とブレークされた基板を搬送する機構を1つの機構で実行できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0028]

以下、この発明の実施形態を、図1から図9に基づいて詳細に説明する。

[0029]

なお、本発明において、「基板」は、その大きさに基づいて、最小単位面積を有する単位基板、複数の単位基板に割断されるマザー基板およびマザー基板が割断されて複数の単位基板からなる小マザー基板に分類される。

本発明において、「基板」には、その材質に基づいて、セラミック基板、プラスチック 基板、半導体基板およびガラス基板が含まれる。

また、本発明において、「基板」には、その形態に基づいて、1枚の基板からなる単板、一対の基板を貼り合わせた貼り合わせ基板および複数の基板を積層した積層基板が含まれる。

[0030]

以下の実施の形態では、液晶表示装置のパネル基板を製造するに際し、一対のガラス基板が貼りあわされたマザー基板または小マザー基板を単位基板に割断する例を示すが、この発明の基板割断装置および基板割断方法は、これらに限定されるものではない。

[0031]

[実施の形態1]

図1はこの発明の基板割断装置の左方からの斜視図であり、図2は前記基板割断装置の右方からの斜視図である。

[0032]

図1および図2において、基板割断装置10は、脆性基板を載置する基板載置部1と、 複数の基板搬送ロボットを有する基板搬送部2と、基板搬送部2によって搬送される基板 をスクライブするスクライブ部3と、スクライブされた基板をブレークするブレーク部4 とから主に構成されている。

[0033]

図1および図2を用いて基板割断装置10の構成と動作の一例を説明する。

が 1.5 mm を超えないサイズ、例えば、 $670 \text{ mm} \times 100 \text{ mm} \times 0.7 \text{ mm}$ のガラス 基板が用いられる。

[0034]

次いで、搬入コンベア12の後端部に搬送されたカセット11から吸着ハンド14が基板を1枚ずつ吸着して載置台15に移動する。この動作を5回繰り返すことによって、載置台15において、基板はその主面が載置台15の主面と平行に、基板5枚が1列になって載置される。載置台15の位置決め部材16が載置台15上の所定位置に基板を位置決めする。なお、空になったカセット11は、搬入コンベア13によって図中矢印B方向に搬送される。

[0035]

次いで、基板の上面を吸着して基板を支持する上面吸着部 2 1 を有する搬送ロボット 2 2 が、ガイドレール 2 0 上を載置台 1 5 まで移動する。上面吸着部 2 1 が 1 列の基板 5 枚を 1 度に吸着して支持し、スクライブテーブル 3 1 へ移動し、スクライブテーブル 3 1 上に基板を載置する。その間、載置台 1 5 には、吸着ハンド 1 4 によって別途に基板 5 枚が一列に載置される。スクライブテーブル 3 1 では、基板の A 面にスクライブラインが形成される。

[0036]

次いで、搬送ロボット24が、ガイドレール20上をスクライブテーブル31まで移動する。搬送ロボット24は、基板の主面を吸着する吸着面が上下に180度反転して基板を支持する反転吸着部23を有する。

[0037]

図3および図4は、反転吸着部23の平面図および側面図である。

図3および図4により、反転吸着部23の構成を説明する。

反転吸着部23は、回転台座51と、パイプ状の回転軸52と、吸着面を形成する複数の吸着ベローズ60とを備えている。

回転台座51は、表面に複数の孔部51aを有し、弾性を有する支持体54で回転軸52に支持されている。回転台座51の孔部51aは、裏面の吸着ベローズ60と連通するように接続されている。

[0038]

回転軸52は、長手方向に分散された孔部55を有し、軸の一端部に配置された後記するモーターの回転軸に接続されている。回転軸52の両端部は、ロータリージョイント56を介して図示しない真空源に接続されている。回転軸52の孔部55は、チューブ58および電磁バルブ57を介して回転台座51の孔部51aに連通している。前記の真空源が駆動されると、電磁バルブ57の切り換えにより、任意の吸着ベローズ60を用いて基板の吸引が可能になる。つまり、基板の大きさによって吸着面の大きさを切り換えることが可能である。

[0039]

図5は、搬送ロボット24における反転吸着部23の配置を説明する斜視図である。 反転吸着部23は、前記したように、ガイドレール20上を走行可能な搬送ロボット2 4に取付けられ、基板をそれぞれの基板の主面で吸着して保持する吸着面を備えた複数の 回転台座51を有する。

[0040]

回転台座51のそれぞれは、回転軸52に支持され、それらの回転軸52によりフレーム59に支持されている。回転軸52のそれぞれが、互いに平行で、回転台座73の長手方向に沿って延びかつ回転台座73の短手方向の幅におけるほぼ中心部分を貫通している

フレーム59には、DCサーボモータ75とラックアンドピニオン76とからなる回転 軸駆動部が取付けられている。それぞれの回転軸52は、その一端がフレーム59に回動 可能に支持され、他端がラックアンドピニオン76を介してDCサーボモータ75に接続 されている。DCサーボモータ75は、図示しない制御部に接続されている。この制御部 は、前記の回転軸駆動部を介して回転軸52の回転角度および回転方向を制御する。

[0041]

図6は、搬送ロボット24と反転吸着部23の動作を説明する斜視図である。

図1、図2および図6を参照しながら、反転吸着部23の動作をさらに説明する。

[0042]

搬送ロボット24がスクライブテーブル31まで移動すると、上面であるA面にスクライブラインが形成された基板を反転吸着部23で吸着する(図6a)。次いで、A面が下面になるように基板を反転させて支持する(図6bから図6c)。次いで、搬送ロボット24は、位置決めテーブル33の上方まで移動するとともに、搬送ロボット26が、位置決めテーブル33の上方まで移動する(図6d)。搬送ロボット26は、基板の上面を吸着して基板を支持する上面吸着部25を有する。

搬送ロボット24と搬送ロボット26は、ガイドレール20上で交差できるよう構成されている。搬送ロボット26の上面吸着部25は、搬送ロボット24の反転吸着部23が吸着支持する基板を受取り、次いで、搬送ロボット24が退避し、搬送ロボット26は位置決めテーブル33面に載置する。

[0043]

位置決めテーブル33は、載置された基板をそのテーブル上の所定位置に位置決めする 位置決め部材34を有する。位置決め部材34は、載置された基板を位置決めテーブル3 3上の所定位置に位置決めする。

次いで、搬送ロボット26は、テーブル33面で位置決めされた基板の上面を上面吸着部25で吸着して基板を支持し、スクライブテーブル35へ移動し、スクライブテーブル35に基板を載置する。スクライブテーブル35では、基板の上面であるB面にスクライブラインが形成される。このとき、基板はほぼ割断状態となる。すなわち、完全に割断された端面を有する単位基板と、完全に割断されていない端面を有する単位基板とが混在する。

$[0\ 0\ 4\ 4\]$

次いで、搬送ロボット28がスクライブテーブル35に移動し、次いで、スクライブラインが形成された基板の上面を上面吸着部27で吸着して基板を支持し、ガイドレール20上をブレークコンベア41まで移動する。 前記の上面吸着部27は、多孔質状部材からなる吸着面を備えている。

多孔質状部材としては、連続気泡を有する発泡プラスチックス、発泡ゴム、焼結金属、あるいは紙を編み込んだものおよびこれらを組み合わせたものを用いることができる。

多孔質状部材からなる吸着面を用いることにより、反転吸着部23の吸着面の面積と前 記吸着面に接触する基板の接触面積との比率が変化しても、基板の吸着が可能になる。よって基板が割断されていてもまたは割断されていなくても、割断状態が異なるサイズの基板を吸着して反転させることができる。

[0045]

図7は、搬出コンベア4の構成を説明する平面図である。

搬出コンベア4は、図7に示すように、コンベアベルト41、42、43と、コンベアベルト41の搬送方向の両端部に配置されたブレーク部材44および45とを備えている。コンベアベルト41は1本のベルトで構成され、コンベアベルト42は図中矢印方向に平行移動可能な2本のベルトで構成され、コンベアベルト43は3本のベルトで構成される。コンベアベルト41上に移動した搬送ロボット28は、上面吸着部27の吸着を解除して基板をコンベアベルト41上に載置する。

[0046]

コンベアベルト41が、上流側(図中左方)に基板を搬送し、上流側に配置されたブレーク部材44で、基板一端側の耳部分(不要な部分)をプッシュしてコンベアベルト41から落とす。

次いで、コンベアベルト41は、ベルトの搬送方向が逆になるよう駆動され、基板の一

端側の耳部分が削除された基板を下流側(図中右方)に搬送する。この搬送動作を行いな がら、下流側に配置されたブレーク部材 4 5 が、基板の他端側の耳部分をプッシュし、開 いた状態のコンベアベルト42の2本のベルトの間に落とす。次いで、コンベアベルト4 2の2本のベルトを接近した状態(図の状態)とし、ブレーク部材45が、短冊状基板の 一端側部分をプッシュして単位基板に完全に割断し、順次、接近した状態のコンベアベル ト42の2本のベルトの上に落とす。

割断された単位基板は、コンベアベルト42からコンベアベルト43に移動して搬送さ れ、次工程へ搬出される。

[0047]

「実施の形態2]

図8および図9を用いてこの発明の基板割断装置の実施の形態3を説明する。

図8は搬送ロボットに取付けられた反転吸着部70の斜視図であり、図9は反転吸着部 70における回転台座の動作を説明するための図である。

[0048]

反転吸着部70は、前記したように、ガイドレール20上を走行可能な搬送ロボットに 取付けられ、図8および図9に示すように、基板をそれぞれの基板の主面で吸着して保持 する吸着面を備えた複数の回転台座73 (吸着部材)を有する。

[0049]

回転台座73には、図3および図4に示したように、前記したパイプ状の回転軸52と 、吸着面を形成する複数の吸着ベローズ60とを備えている。回転台座73の吸着機構は 、前記した回転台座51と共通するので説明を省略する。

[0050]

反転吸着部70は、図9に示すように、同一平面内にありかつ互いに平行な回転軸72 を有する。

回転台座73のそれぞれは、回転軸72に支持され、それらの回転軸72によりフレー ム 5 9 に支持されている。回転軸 7 2 のそれぞれが、互いに平行で、回転台座 7 3 の長手 方向に沿って延びかつ回転台座73の短手方向の幅におけるほぼ中心部分を貫通している

反転吸着部70は、回転台座73の回転軸72を回動させる後記するDCサーボモータ 一75(回転軸駆動部)と、このモーター75に接続された回転軸72の回転角度および 回転方向を制御する図示しない制御部と、回転軸72に対して、それぞれの軸線間の距離 を変位させる回転軸変位部とを有する。

[0051]

フレーム79には、前記モーター75とラックアンドピニオン76とからなる回転軸駆 動部が取付けられている。それぞれの回転軸72は、その一端がフレーム79に回動可能 に支持され、他端がラックアンドピニオン76を介して前記モーター75に接続されてい る。モーター75は、図示しない制御部に接続されている。

[0052]

回転軸変位部について、以下に説明する。

ラックアンドピニオン76を構成するピニオンギア76aは、図示しない付勢手段によ りラックギア76bに付勢されており、この付勢力に抗してピニオンギア76aをラック ギア76bのギア列から離す方向(図中では上方)に力を作用させる。このような力を作 用させるために、この実施の形態では、電磁石を用いる。

この電磁石は制御部に接続され、静止状態にある回転台座73aおよび回転台座73c の間に位置する回転台座73bを図中矢印方向にわずかに移動させることができる。

[0053]

制御部は、モーター75が回転軸72を回動させる際に、この回動と同時または回動後 に、隣り合う各回転台座73の回転軸72をそれぞれの軸線間の距離が長くなるように変 位させる。

すなわち、隣り合う回転台座73を異なる回転方向に回転させるだけでは割断された基

板どうしの端面が接触しあうが、図9中の回転台座73bを、基板のスクライブ面に応じ て、静止した回転台座73aおよび回転台座73cに対して矢印方向に移動させることに より、割断された基板どうしの端面が接触するのを防止できる。

[0054]

[実施の形態3]

- 図10および図11を用いてこの発明の基板割断装置の実施の形態3を説明する。
- 図10は搬送ロボットに取付けられた反転吸着部70の斜視図であり、図11は前記反 転吸着部70における回転台座の動作を説明するための図である。

[0055]

この実施の形態3では、フレーム79の対向する2つの辺部に、回転軸72のそれぞれ の両端部を回動可能に支持し、水平方向に回転台座73のそれぞれを移動させるための一 対のレール78が配設されている。それぞれのレール78には、回転軸72のそれぞれの 端部が移動可能に係合されている。

[0056]

制御部は、モーター75が回転軸72を回動させる際に、この回動と同時または回動後 に、隣り合う各回転台座73の回転軸72をそれぞれの軸線間の距離が長くなるように変 位させる。

すなわち、図11に示したように、隣り合う回転台座73を異なる回転方向に回転させ るだけでは割断された基板どうしの端面が接触しあうが、隣り合う各回転台座73の回転 軸72の間隔S1、S2を広げるよう回転台座73をレール71に沿って移動させる。こ れにより、割断された基板どうしの端面が接触するのを防止できる。

【産業上の利用可能性】

[0057]

脆性を有するマザー基板にスクライブラインを形成し、形成されたスクライブラインに 沿って前記マザー基板を単位基板に割断する基板割断方法および基板割断装置において、 基板の反転に要する面積は小さくなり、装置の設置面積を抑えることができる。さらに、 これらの基板を反転する際に基板に加わる外力を小さくすることができるので、好ましく ないクラックや欠けの発生を抑えることができる。

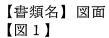
【図面の簡単な説明】

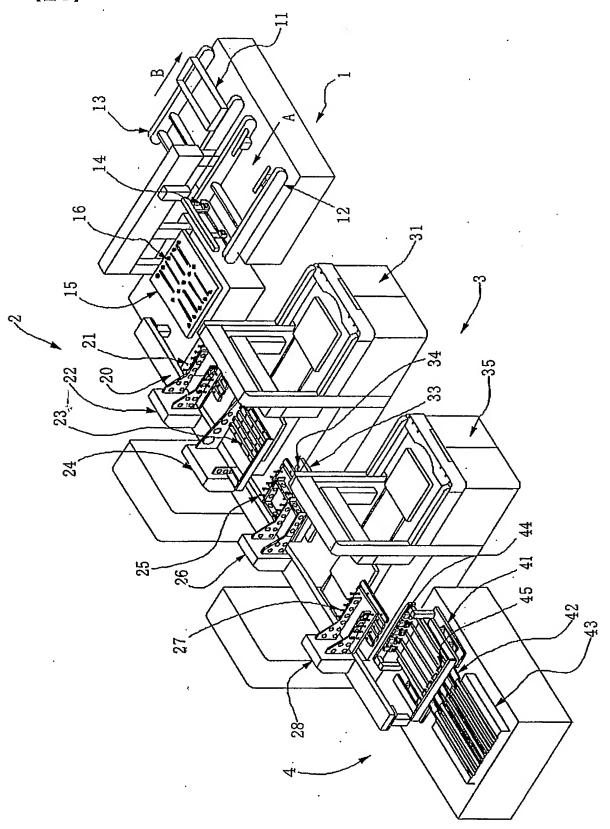
- 【図1】この発明の基板割断装置の左方からの斜視図である。
- 【図2】図1の基板割断装置の左方からの斜視図である。
- 【図3】図1の基板割断装置の反転吸着部の平面図である。
- 【図4】図3の基板割断装置の反転吸着部の側面図である。
- 【図5】反転吸着部の配置を説明する斜視図である。
- 【図6】 反転吸着部の動作を説明する斜視図である。
- 【図7】搬出コンベアの構成を説明する平面図である。
- 【図8】反転吸着部の別の一例を示す斜視図である。
- 【図9】図8の反転吸着部の動作を説明する図である。
- 【図10】反転吸着部のさらに別の一例を示す斜視図である。
- 【図11】図10の反転吸着部の動作を説明する図である。

【符号の説明】

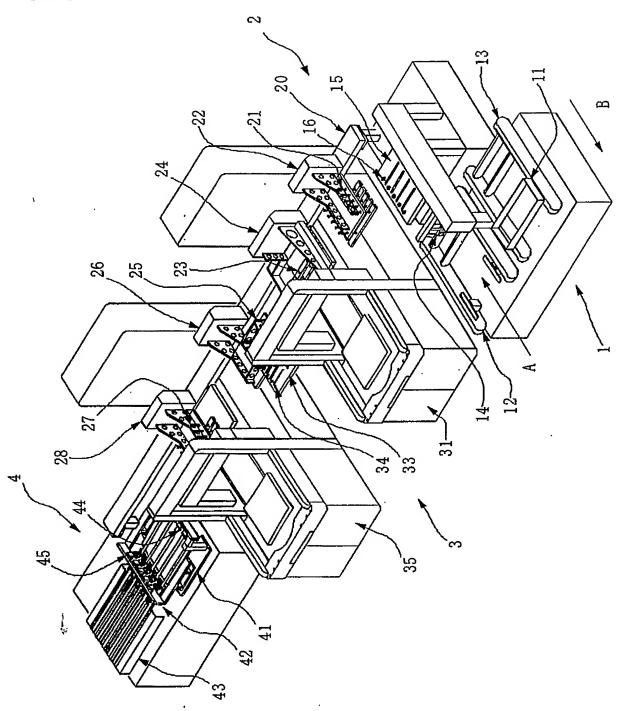
- 1 基板載置部
- 2 基板搬送部
- スクライブ部
- ブレーク部
- 1 0 基板割断装置
- 22 搬送ロボット
- 23 反転吸着部
- 24 搬送ロボット
- 26 搬送ロボット

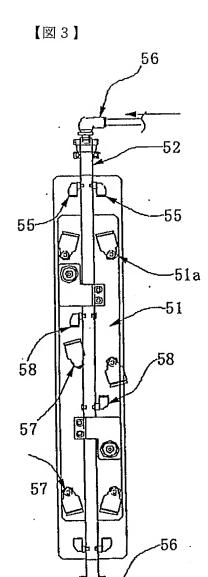
- 28 搬送ロボット
- 31 スクライブテーブル
- 35 スクライブテーブル
- 41 ブレークコンベア
- 51 回転台座
- 5 2 回転軸
- 70 反転吸着部
- 72 回転軸
- 73 回転台座
- 75 DCサーボモーター
- 76 ラックアンドピニオン
- 78 レール

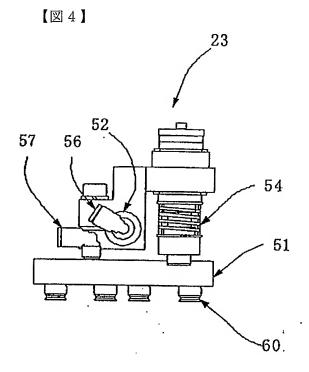


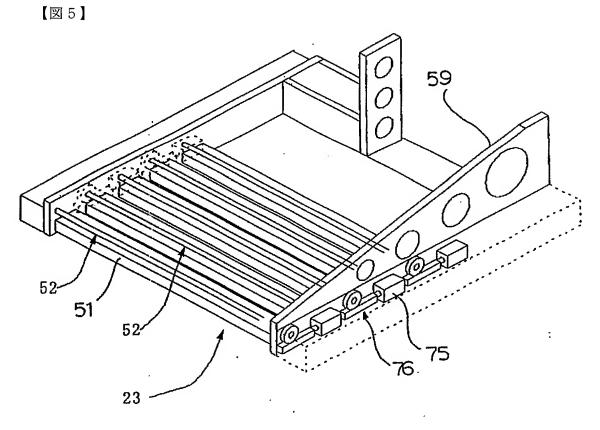


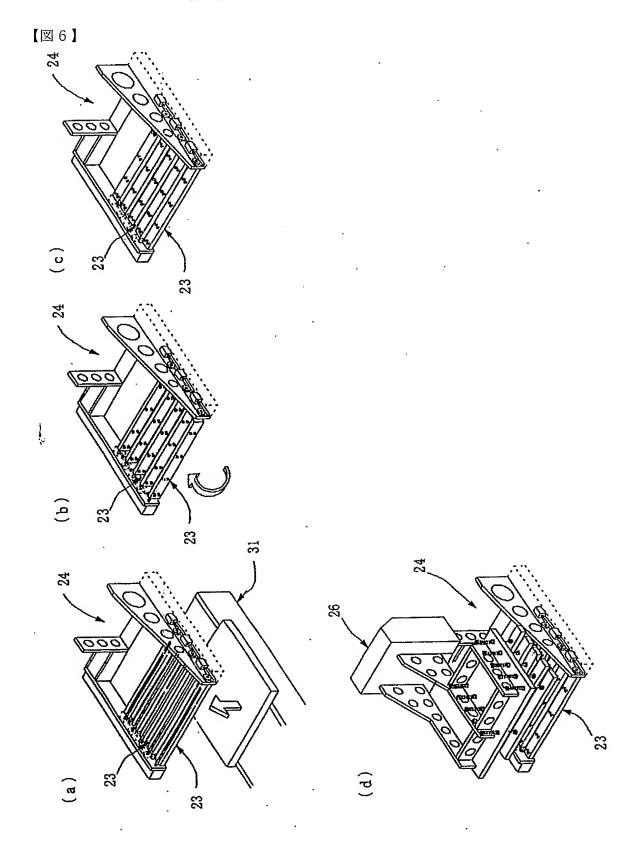
【図2】

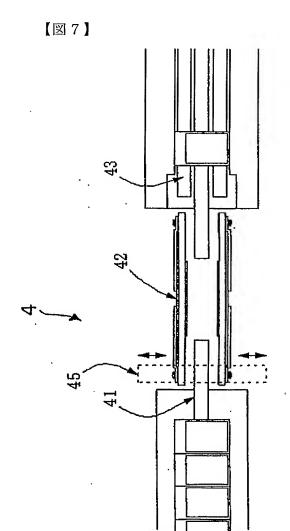




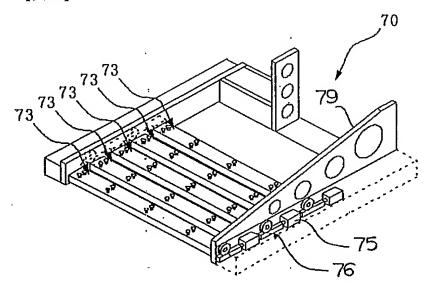




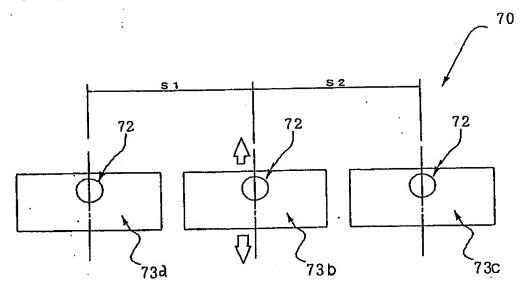




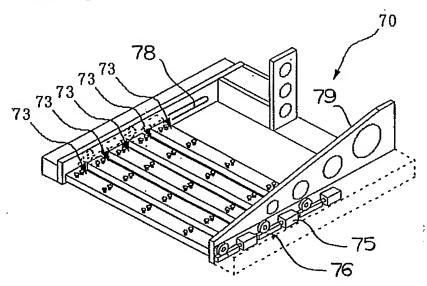
【図8】



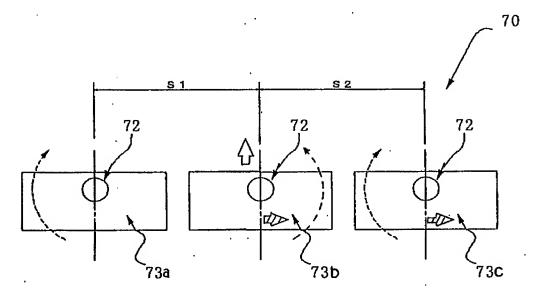
【図9】







【図11】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 基板の反転を含む基板搬送における基板の損傷を防止し、これらの基板搬送機構を有する基板割断装置の小型化によって設置面積を減少させることができる基板割断方法および基板割断装置が提供される。

【解決手段】 脆性を有するマザー基板を単位基板に割断する基板割断装置は、マザー基板にスクライブラインを形成するスクライブ部3と、形成されたスクライブラインに沿って前記マザー基板をブレークするブレーク部4と、少なくとも前記各部の間で前記マザー基板または前記単位基板を搬送する基板搬送部2とを具備し、基板搬送部2が、前記基板をそれぞれの基板の主面で吸着して保持する吸着面を備えた複数の回転台座51,73を有し、回転台座51,73のそれぞれは、回転軸52,72を有し、前記基板を吸着保持した状態で少なくとも前記基板の両主面が上下方向に反転するよう前記各基板をそれぞれの回転軸52,72周りに回動させる基板吸着回動手段を有する。

【選択図】 図6

特願2003-436226

出願人履歴情報

識別番号

[390000608]

1. 変更年月日 [変更理由]

2002年 2月 5日

住所氏名

住所変更 大阪府吹田市南金田2丁目12番12号

三星ダイヤモンド工業株式会社